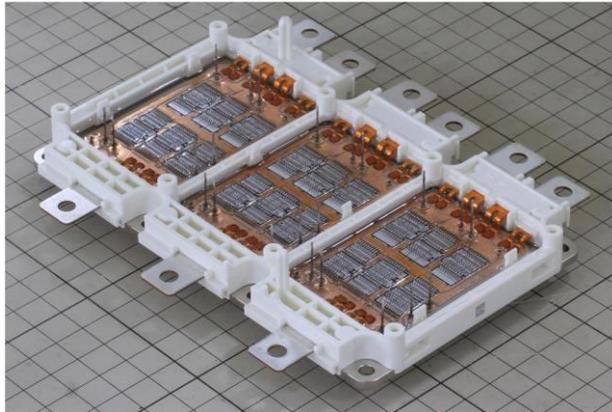
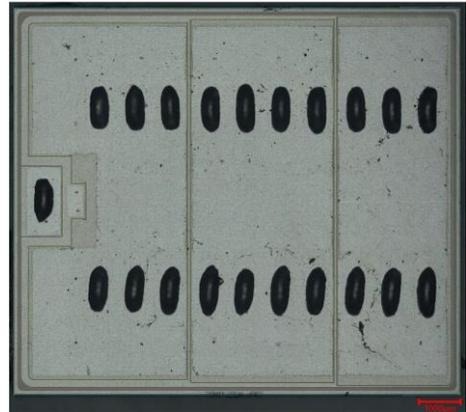


Infineon製 650V 車載用IGBTモジュール「EDT2」 構造解析レポート



モジュール外観



チップ外観

製品概要

型番 : FS950R08A6P2B

- ・Infineon製車載用 6 in 1 Si IGBT Module (Vces 750V、Ic 950A)
- ・チップサイズ: 10.76mm x 9.29mm = 99.96mm ウェハ(推定)
トレンチ型ゲート マイクロパターントレンチ
- ・同社IGBT EDT2は、車載用に設計されたIGBTで、欧州、中国のEV車両(300~400V系)を中心に本タイプの搭載が確認されており、世界で最も多く車両に搭載されているIGBT
※日本は日産Leaf、Note ePowerで採用
- ・本製品はハイブリッド車および電気自動車向けにリボンボンドの直接冷却ベースプレート NTC温度センサー、PressFITコンタクト技術を採用した最適化された超小型の6パックモジュール。

レポート内容

○Si-IGBTパワーモジュール、搭載チップ構造解析レポート

- ・内部レイアウト、搭載チップ外観(搭載チップ数、チップサイズ、温度センサの配置)
- ・モジュール断面構造解析、材料分析(ダイアタッチ、AMC基板、ワイヤ材料など)
- ・チップサイズ(活性領域面積)、セルピッチ、ゲート絶縁膜測長、終端部構造

レポート価格: 60万円(税別)

目次

Page

1. デバイスサマリー	...	3
1-1. 解析結果まとめ	...	4
2. モジュール構造解析		
2-1. 外観観察	...	9
2-2. モジュール内部観察	...	12
2-3. 搭載チップ観察	...	17
2-4. モジュール断面観察	...	18
3. Si-IGBT 構造解析		
3-1. 平面構造解析(OM)	...	44
3-2. 平面構造解析(SEM)	...	60
3-3. セル領域 断面構造解析	...	78
3-4. 外周部 断面構造解析	...	89